

KEC, 최소형 반도체 패키지 ELP 개발

KEC는 9월22일 세계에서 가장 작은 반도체 패키지(Package) ELP(Extremely small Leadless Package) 개발에 성공해 12월부터 출시한다고 발표했다.

KEC가 개발한 패키지는 가로 0.6mm, 세로 0.3mm, 두께 0.28mm 크기로 최소형이며 두께도 일본 경쟁제품보다 0.02mm 얇아 세계 초박형인 것으로 알려졌다.

<화학저널 2005/09/23>